(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109333831 A
(43)申请公布日 2019.02.15

(21)申请号 201811527976.9

(22)申请日 2018.12.13

(71)申请人 佛山市爱陶机电设备有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区狮山镇罗村下柏管理区第三工业区创业路创业工业园A号

(72)发明人 丁建盛 刘钊辉 敖杰

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
代理人 曾燕玲

(51)Int.Cl.
B28D 1/04(2006.01)
B28D 1/22(2006.01)

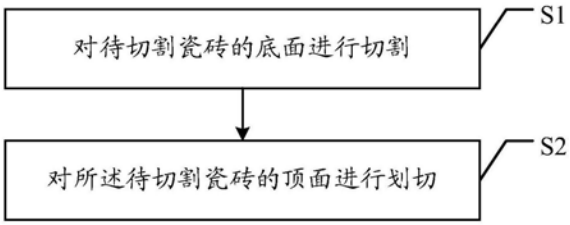
权利要求书2页 说明书7页 附图6页

(54)发明名称

一种瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备

(57)摘要

本发明公开了一种瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备，通过采用切底划面的瓷砖切割方法，一把刀将待切割瓷砖的底面切割至一定的深度，另一把刀将待切割瓷砖的顶面划切出痕迹，后面采用分断装置将待切割瓷砖沿切割线分断，能够有效降低待切割瓷砖在切割过程中出现崩边、掉底等破损的概率。本发明瓷砖切割设备包括瓷砖切割设备主体，瓷砖切割设备主体包含有输送机构及切割机构，切割机构包括切底模块及划面模块；切底模块设置在输送机构下方，并用于对待切割瓷砖的底面进行切割；划面模块设置在输送机构上方，并用于对待切割瓷砖的顶面划切。



CN 109333831 A

1.一种瓷砖切割工艺,其特征在于,包括:

S1:对待切割瓷砖的底面进行切割;

S2:对所述待切割瓷砖的顶面进行划切;

步骤S1及步骤S2不分先后顺序。

2.根据权利要求1所述的瓷砖切割工艺,其特征在于,在步骤S2之后还包括:

将划切后的所述待切割瓷砖沿划切线路分离。

3.根据权利要求1或2所述的瓷砖切割工艺,其特征在于,在步骤S1之前还包括:

对所述待切割瓷砖进行对中或导向处理,并使所述待切割瓷砖按照设定的位置进入切割设备。

4.一种瓷砖切割设备,采用权利要求1至3中任一项所述的瓷砖切割工艺进行工作,包括瓷砖切割设备主体,所述瓷砖切割设备主体包含有输送机构及切割机构,其特征在于,所述切割机构包括切底模块及划面模块;

所述切底模块设置在所述输送机构下方,并用于对待切割瓷砖的底面进行切割;

所述划面模块设置在所述输送机构上方,并用于对所述待切割瓷砖的顶面划切。

5.根据权利要求4所述的瓷砖切割设备,其特征在于,所述切割机构还包括切面模块;

所述切面模块设置在所述输送机构上方,并用于对所述待切割瓷砖的顶面进行切割。

6.根据权利要求4或5所述的瓷砖切割设备,其特征在于,

所述切底模块包括有切割电机、电机皮带轮、主轴、主轴皮带轮、锯片及三角带;

所述电机皮带轮固定在所述切割电机上,所述主轴皮带轮及所述锯片分别设置在所述主轴的两端,所述电机皮带轮通过所述三角带与所述主轴皮带轮连接。

7.根据权利要求6所述的瓷砖切割设备,其特征在于,

所述划面模块包括驱动气缸、连接板及划面工具;

所述划面工具通过所述连接板与所述驱动气缸连接,所述驱动气缸用于控制所述划面工具的升降。

8.根据权利要求7所述的瓷砖切割设备,其特征在于,所述划面工具为合金划刀或合金刀轮。

9.根据权利要求7所述的瓷砖切割设备,其特征在于,所述瓷砖切割设备主体还包括机架、输送机构、对中机构、压紧机构、过渡机构及断开机构;

所述断开机构包括顶断模块及后输送模块;

以所述待切割瓷砖行进方向为前方,所述后输送模块及所述输送机构依次设置在所述机架上,其中所述输送机构包括有驱动模块及两条以所述待切割瓷砖行进方向为对称轴对称设置的传送带,两条所述传动带之间设置有切割间隙,所述切底模块及所述划面模块分别设置在所述切割间隙的上下两侧;

以所述待切割瓷砖行进方向为前方,所述顶断模块、所述过渡机构、所述划面模块及所述对中机构依次设置于所述输送机构及所述后输送模块上方,其中所述对中机构用于对所述待切割瓷砖的位置进行对中定位或导向;

所述压紧机构设置于所述对中机构上方,用于压紧所述待切割瓷砖;

所述过渡机构用于对经过划切后的所述待切割瓷砖进行吸水及对中定位;

所述顶断模块用于将经过划切后的所述待切割瓷砖断开。

10.根据权利要求9所述的瓷砖切割设备,其特征在于,

所述过渡机构包括有固定架、海绵辊筒及导向轮组;

所述固定架安装于所述机架上;

所述海绵辊筒通过设置在其两端的辊筒支架与所述固定架连接;

所述导向轮组包括对称设置在所述输送机构两侧的左侧导向轮及右侧导向轮;所述左侧导向轮包括有左侧调整支架,所述左侧调整支架下方横向设置有若干个滑轮;所述右侧导向轮包括有右侧调整支架,所述右侧调整支架下方横向设置有若干个滑轮;所述左侧调整支架与所述右侧调整支架均通过螺栓安装在所述固定架顶部,且两者成八字形设置。

一种瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备

技术领域

[0001] 本发明涉及瓷砖加工领域，尤其涉及一种瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备。

背景技术

[0002] 瓷砖切割设备是一种专门用于切割瓷砖的全自动或半自动设备。

[0003] 现有技术中的瓷砖切割设备一般采用直接切割的方式对瓷砖板材进行分切，由于设备老化或切刀刀轮磨损等情况，这种瓷砖切割设备及切割工艺一方面存在容易损坏瓷砖板材，例如破裂或崩边等情况，另一方面存在切割余量过大，对瓷砖板材损耗比较大的缺陷。

[0004] 因此，针对上述情况，如何改进现有瓷砖切割设备的结构或瓷砖切割工艺，从而可以解决上述的问题，成为本领域技术人员亟待解决的重要技术问题。

发明内容

[0005] 本发明公开了一种瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备，通过采用切底划面的瓷砖切割方法，一把刀将待切割瓷砖的底面切割至一定的深度，另一把刀将待切割瓷砖的顶面划切出痕迹，后面采用分断装置将待切割瓷砖沿切割线分断，能够有效降低待切割瓷砖在切割过程中出现崩边、掉底等破损的概率。

[0006] 本发明提供的瓷砖切割工艺，包括：

[0007] S1：对待切割瓷砖的底面进行切割；

[0008] S2：对所述待切割瓷砖的顶面进行划切；

[0009] 步骤S1及步骤S2不分先后顺序。

[0010] 优选的，

[0011] 在步骤S2之后还包括：

[0012] 将划切后的所述待切割瓷砖沿划切线路分离。

[0013] 优选的，

[0014] 在步骤S1之前还包括：

[0015] 对所述待切割瓷砖进行对中或导向处理，并使所述待切割瓷砖按照设定的位置进入切割设备。

[0016] 本发明提供的瓷砖切割设备，采用上述的瓷砖切割工艺进行工作，包括瓷砖切割设备主体，所述瓷砖切割设备主体包含有输送机构及切割机构，所述切割机构包括切底模块及划面模块；

[0017] 所述切底模块设置在所述输送机构下方，并用于对待切割瓷砖的底面进行切割；

[0018] 所述划面模块设置在所述输送机构上方，并用于对所述待切割瓷砖的顶面划切。

[0019] 优选的，

[0020] 所述切割机构还包括切面模块；

[0021] 所述切面模块设置在所述输送机构上方，并用于对所述待切割瓷砖的顶面进行切

割。

[0022] 优选的，

[0023] 所述切底模块包括有切割电机、电机皮带轮、主轴、主轴皮带轮、锯片及三角带；

[0024] 所述电机皮带轮固定在所述切割电机上，所述主轴皮带轮及所述锯片分别设置在所述主轴的两端，所述电机皮带轮通过所述三角带与所述主轴皮带轮连接。

[0025] 优选的，

[0026] 所述划面模块包括驱动气缸、连接板及划面工具；

[0027] 所述划面工具通过所述连接板与所述驱动气缸连接，所述驱动气缸用于控制所述划面工具的升降。

[0028] 优选的，

[0029] 所述划面工具为合金划刀或合金刀轮。

[0030] 优选的，

[0031] 所述瓷砖切割设备主体还包括机架、输送机构、对中机构、压紧机构、过渡机构及断开机构；

[0032] 所述断开机构包括顶断模块及后输送模块；

[0033] 以所述待切割瓷砖行进方向为前方，所述后输送模块及所述输送机构依次设置在所述机架上，其中所述输送机构包括有驱动模块及两条以所述待切割瓷砖行进方向为对称轴对称设置的传送带，两条所述传动带之间设置有切割间隙，所述切底模块及所述划面模块分别设置在所述切割间隙的上下两侧；

[0034] 以所述待切割瓷砖行进方向为前方，所述顶断模块、所述过渡机构、所述划面模块及所述对中机构依次设置于所述输送机构及所述后输送模块上方，其中所述对中机构用于对所述待切割瓷砖的位置进行对中定位或导向；

[0035] 所述压紧机构设置于所述对中机构上方，用于压紧所述待切割瓷砖；

[0036] 所述过渡机构用于对经过划切后的所述待切割瓷砖进行吸水及对中定位；

[0037] 所述顶断模块用于将经过划切后的所述待切割瓷砖断开。

[0038] 优选的，

[0039] 所述过渡机构包括有固定架、海绵辊筒及导向轮组；

[0040] 所述固定架安装于所述机架上；

[0041] 所述海绵辊筒通过设置在其两端的辊筒支架与所述固定架连接；

[0042] 所述导向轮组包括对称设置在所述输送机构两侧的左侧导向轮及右侧导向轮；所述左侧导向轮包括有左侧调整支架，所述左侧调整支架下方横向设置有若干个滑轮；所述右侧导向轮包括有右侧调整支架，所述右侧调整支架下方横向设置有若干个滑轮；所述左侧调整支架与所述右侧调整支架均通过螺栓安装在所述固定架顶部，且两者成八字形设置。

[0043] 本发明的瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备具有以下特点：

[0044] 1、开创性地采用切底划面的瓷砖切割方法，亦即一把刀将待切割瓷砖的底面切割至一定的深度，另一把刀将待切割瓷砖的顶面划切出痕迹，后面采用分断装置将待切割瓷砖沿切割线分断，能够有效降低待切割瓷砖在切割过程中出现崩边、掉底等破损的概率；

[0045] 2、对待切割瓷砖的切割余量小，从而降低对待切割瓷砖的损耗；

[0046] 3、适应性广，能够满足不同类型板材的切割。

附图说明

[0047] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0048] 图1为本发明瓷砖切割工艺第一实施例的流程图；

[0049] 图2为本发明瓷砖切割工艺第二实施例的流程图；

[0050] 图3为本发明瓷砖切割设备实施例的结构示意图；

[0051] 图4为本发明瓷砖切割设备另一个实施例的结构示意图；

[0052] 图5为本发明瓷砖切割设备实施例中输送机构1的结构示意图；

[0053] 图6为本发明瓷砖切割设备实施例中切底模块21的结构示意图；

[0054] 图7为本发明瓷砖切割设备实施例中划面模块22的结构示意图；

[0055] 图8为本发明瓷砖切割设备实施例中对中机构4的结构示意图；

[0056] 图9为本发明瓷砖切割设备实施例中压紧机构5的结构示意图；

[0057] 图10为本发明瓷砖切割设备实施例中过渡机构6的结构示意图；

[0058] 图11为本发明瓷砖切割设备实施例中断开机构7的结构示意图。

具体实施方式

[0059] 本发明公开了一种瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备，通过采用切底划面的瓷砖切割方法，一把刀将待切割瓷砖的底面切割至一定的深度，另一把刀将待切割瓷砖的顶面划切出痕迹，后面采用分断装置将待切割瓷砖沿切割线分断，能够有效降低待切割瓷砖在切割过程中出现崩边、掉底等破损的概率。

[0060] 必须说明指出的是，在本发明中，切割是指通过锯片等工具对待切割瓷砖进行一定厚度但是未将其完全切断的处理，划切是指通过划刀刀轮或刀头等工具在待切割瓷砖的表面划出一道比较浅的细痕。

[0061] 下面结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚和详细的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。请参阅图1，为本发明瓷砖切割工艺第一实施例，包括：

[0062] S1：对待切割瓷砖的底面进行切割；

[0063] 待切割瓷砖经过人工或输送机构输送过来后，首先可以对待切割瓷砖的底面进行切割，亦即切底操作，并使待切割瓷砖底部形成一道比较深的切痕。

[0064] S2：对所述待切割瓷砖的顶面进行划切。

[0065] 在待切割瓷砖进行切底操作时或已经完成切底操作后，对待切割瓷砖的顶面进行划切，并在待切割瓷砖表面形成一道比较浅的划痕。

[0066] 此时待切割瓷砖的切割处理工艺完成，通过人工或其他能够将待切割瓷砖分离的机构处理即可将待切割瓷砖分块，而不会容易出现崩角或开裂的情况。上述的其他能够将

待切割瓷砖分离的机构具体可以是，沿切痕将待切割瓷砖顶断的顶断机构、掰断机构或通过设置在划痕两侧的滚轮组及设置在切痕处的支撑件组成的滚断机构，在此处不做限定。

[0067] 需要说明的是，步骤S1及步骤S2不分先后顺序，亦即本发明瓷砖切割工艺也可以是，先对待切割瓷砖的顶面进行划切，然后对待切割瓷砖的底面进行切割，还可以是同时对待切割瓷砖的底面进行切割及对待切割瓷砖的顶面进行划切，具体采用哪种顺序，可以根据机械设备的结构或设计要求进行选择，在此处不做限定。因此，本发明瓷砖切割工艺第一实施例及第二实施例只是恰好选取了先对待切割瓷砖的底面进行切割，再对待切割瓷砖的顶面进行划切的顺序作为示例，而并不是代表本发明瓷砖切割工艺只有这种顺序形式。

[0068] 上面介绍了本发明瓷砖切割工艺第一实施例，下面对本发明瓷砖切割工艺第二实施例进行详细的描述，请参阅图2，本发明瓷砖切割工艺第二实施例，包括：

[0069] 201：对所述待切割瓷砖进行对中或导向处理，并使所述待切割瓷砖按照设定的位置进入切割设备；

[0070] 在待切割瓷砖上料后，首先可以对待切割瓷砖进行对中或导向处理，使待切割瓷砖按照设定的位置进入切割设备。需要说明的是，也可以通过机械手直接将待切割瓷砖上料至设定的切割位置，而不需要增加对中处理过程，在此处不做限定。

[0071] 202：对待切割瓷砖的底面进行切割；

[0072] 接着可以对待切割瓷砖的底面进行切割，亦即切底操作，并使待切割瓷砖底部形成一道比较深的切痕。

[0073] 203：对所述待切割瓷砖的顶面进行划切；

[0074] 在待切割瓷砖进行切底操作时或已经完成切底操作后，对待切割瓷砖的顶面进行划切，并在待切割瓷砖表面形成一道比较浅的划痕。

[0075] 204：将划切后的所述待切割瓷砖沿划切线路分离。

[0076] 最后通过人工或其他能够将待切割瓷砖分离的机构处理即可将待切割瓷砖划切线路分离，而不会容易出现崩角或开裂的情况。

[0077] 必须指出的是，在步骤201及步骤203之间还可以包括步骤：对所述待切割瓷砖的顶面进行切割。对所述待切割瓷砖的顶面进行切割的过程跟步骤202基本相同，不同的是，两个步骤的切割深度可以不一样，在此处不做限定。

[0078] 上面介绍了本发明瓷砖切割工艺第二实施例，下面对本发明瓷砖切割设备实施例进行详细的描述，需要说明的是，本发明瓷砖切割设备均采用上述的瓷砖切割工艺，请参阅图3至图7，本发明瓷砖切割设备实施例，包括瓷砖切割设备主体，所述瓷砖切割设备主体包含有输送机构1及切割机构2，所述切割机构包括切底模块21及划面模块22；

[0079] 所述切底模块21设置在所述输送机构1下方，并用于对待切割瓷砖的底面进行切割；

[0080] 所述划面模块22设置在所述输送机构1上方，并用于对所述待切割瓷砖的顶面划切；

[0081] 在本发明实施例中，以待切割板材行进方向为前方，切底模块21及划面模块22的相对位置有三种情况，具体为，切底模块21在划面模块22之前，对齐或之后，这三种不同的相对位置关系可以根据瓷砖切割设备的具体结构及设计要求选取，在此处不做限定。下面以切底模块21位于划面模块22之后的情况进行描述，工作时，输送机构1将待切割瓷砖至切

底模块21处，并由切底模块21对待切割瓷砖的底面进行切割，亦即切底操作，并使待切割瓷砖底部形成一道比较深的切痕；在待切割瓷砖进行切底操作时或已经完成切底操作后，划面模块22对待切割瓷砖的顶面进行划切，并在待切割瓷砖表面形成一道比较浅的划痕。

[0082] 此时待切割瓷砖的切割处理工艺完成，通过人工或其他能够将待切割瓷砖分离的机构处理即可将待切割瓷砖分块，而不会容易出现崩角或开裂的情况。上述的其他能够将待切割瓷砖分离的机构具体可以是，沿切痕将待切割瓷砖顶断的顶断机构、掰断机构或通过设置在划痕两侧的滚轮组及设置在切痕处的支撑件组成的滚断机构，在此处不做限定。

[0083] 优选的，

[0084] 所述切割机构2还包括切面模块；

[0085] 所述切面模块设置在所述输送机构1上方，并用于对所述待切割瓷砖的顶面进行切割。

[0086] 需要说明的是，由于切面模块跟切底模块21的功能相同，因此切面模块可以采用跟切底模块21相同的结构，在此处不做限定。

[0087] 优选的，

[0088] 所述划面模块22包括驱动气缸221、连接板222及划面工具223；

[0089] 所述划面工具223通过所述连接板222与所述驱动气缸221连接，所述驱动气缸221用于控制所述划面工具223的升降。

[0090] 优选的，

[0091] 所述划面工具223为合金划刀或合金刀轮。

[0092] 需要进行划面工序，有驱动气缸221通过控制连接板222的移动，进而带动划面工具223升降的方式，即可实现调节划面工具223与待切割瓷砖之间的相对距离。

[0093] 优选的，

[0094] 所述瓷砖切割设备主体还包括机架3、输送机构1、对中机构4、压紧机构5、过渡机构6及断开机构7；

[0095] 所述断开机构7包括顶断模块71及后输送模块72；

[0096] 以所述待切割瓷砖行进方向为前方，所述后输送模块72及所述输送机构1依次设置在所述机架3上，其中所述输送机构1包括有驱动模块11及两条以所述待切割瓷砖行进方向为对称轴对称设置的传送带12，两条所述传动带12之间设置有切割间隙121，所述切底模块21及所述划面模块22分别设置在所述切割间隙121的上下两侧；

[0097] 以所述待切割瓷砖行进方向为前方，所述顶断模块71、所述过渡机构6、所述划面模块22及所述对中机构4依次设置于所述输送机构1及所述后输送模块72上方，其中所述对中机构4用于对所述待切割瓷砖的位置进行对中定位或导向；

[0098] 所述压紧机构5设置于所述对中机构上方，用于压紧所述待切割瓷砖；

[0099] 所述过渡机构6用于对经过划切后的所述待切割瓷砖进行吸水及对中定位；

[0100] 所述顶断模块71用于将经过划切后的所述待切割瓷砖断开。

[0101] 工作时，驱动模块11，具体可以是伺服电机，驱动传送带12，与上方的压紧机构5通过共同夹持的方式输送待切割瓷砖，与此同时，对中机构4工作并将待切割瓷砖的位置进行对中定位，使待切割瓷砖位于设定的切割位置，并在待切割瓷砖至切底模块21处，由切底模块21对待切割瓷砖的底面进行切割，亦即切底操作，并使待切割瓷砖底部形成一道比较深

的切痕;在待切割瓷砖进行切底操作时或已经完成切底操作后,划面模块22对待切割瓷砖的顶面进行划切,并在待切割瓷砖表面形成一道比较浅的划痕;接着过渡机构6用于对经过划切后的所述待切割瓷砖进行吸水及对中定位,在此过程中,会将待切割瓷砖切割过程中产生的水分吸收及将待切割瓷砖再次对中定位,使待切割瓷砖位于设定的顶断位置,最后由顶断模块71将经过划切后的待切割瓷砖断开,完成对待切割瓷砖的分切。

[0102] 本发明的对中机构4、压紧机构5及顶断模块71的具体结构可以如下:

[0103] 其中对中机构4包括有左支撑板41及右支撑板42,左支撑板41及右支撑板42对称设置在输送机构1两侧,左支撑板41及右支撑板42固之间设有滑轨43;所述滑轨43从左到右依次设有第一滑动座44、第二滑动座45及第三滑动座46,第一滑动座44及第三滑动座46上均设有对中调节手轮,第一滑动座44下方横向设置有若干个滑轮,第三滑动座46下方横向设置有若干个滑轮;第二滑动座45设于滑轨43中部,第二滑动座45下方纵向设置有若干个滑轮.

[0104] 压紧机构5包括有前端手轮支架51及后端手轮支架52,于前端手轮支架51及后端手轮支架52分别连接有前端调节手轮53及后端调节手轮54,前端调节手轮53及后端调节手轮54下方连接有矩形支架55,矩形支架55下方横向设置有若干个滑轮。

[0105] 断开机构7包括顶断模块71及后输送模块72,其中顶断模块71包括侧面夹送单元711、压轮单元712及顶刀单元713。

[0106] 优选的,

[0107] 所述切底模块21包括有切割电机211、电机皮带轮212、主轴213、主轴皮带轮214、锯片215及三角带216;

[0108] 所述电机皮带轮212固定在所述切割电机211上,所述主轴皮带轮214及所述锯片215分别设置在所述主轴213的两端,所述电机皮带轮212通过所述三角带216与所述主轴皮带轮212连接。

[0109] 工作时,由切割电机211通过电机皮带轮212及三角带216带动主轴皮带轮214,进而通过主轴213带动锯片215对待切割瓷砖进行切底工序。

[0110] 优选的,

[0111] 所述过渡机构6包括有固定架61、海绵辊筒62及导向轮组63;

[0112] 所述固定架61安装于所述机架3上;

[0113] 所述海绵辊筒62通过设置在其两端的辊筒支架64与所述固定架61连接;

[0114] 所述导向轮组63包括对称设置在所述输送机构1两侧的左侧导向轮631及右侧导向轮632;所述左侧导向轮631包括有左侧调整支架,所述左侧调整支架下方横向设置有若干个滑轮;所述右侧导向轮632包括有右侧调整支架,所述右侧调整支架下方横向设置有若干个滑轮;所述左侧调整支架与所述右侧调整支架均通过螺栓安装在所述固定架61顶部,且两者成八字形设置。

[0115] 在上述结构设计中,待切割瓷砖切割完以后表面有水,进入过渡机构6时,海绵辊筒62吸干待切割瓷砖表面的水分。调节辊筒支架64的宽度方向位置,可以调节导向轮组63之间的宽度,在待切割瓷砖过渡到后面断开机构7的时候不会走歪。

[0116] 本发明的瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备具有以下特点:

[0117] 1、开创性地采用切底划面的瓷砖切割方法,亦即一把刀将待切割瓷砖的底面切割

至一定的深度，另一把刀将待切割瓷砖的顶面划切出痕迹，后面采用分断装置将待切割瓷砖沿切割线分断，能够有效降低待切割瓷砖在切割过程中出现崩边、掉底等破损的概率；

[0118] 2、对待切割瓷砖的切割余量小，从而降低对待切割瓷砖的损耗；

[0119] 3、适应性广，能够满足不同类型板材的切割。

[0120] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成，所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。

[0121] 以上对本发明所提供的瓷砖切割工艺及瓷砖切割设备进行了详细介绍，对于本领域的一般技术人员，依据本发明实施例的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

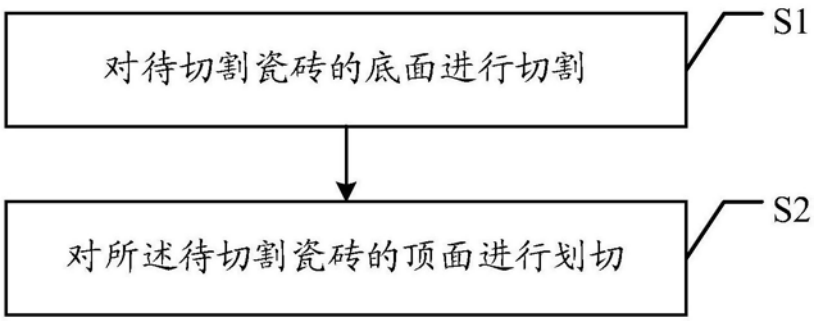

对待切割瓷砖的底面进行切割
S1
对所述待切割瓷砖的顶面进行划切
S2

图1

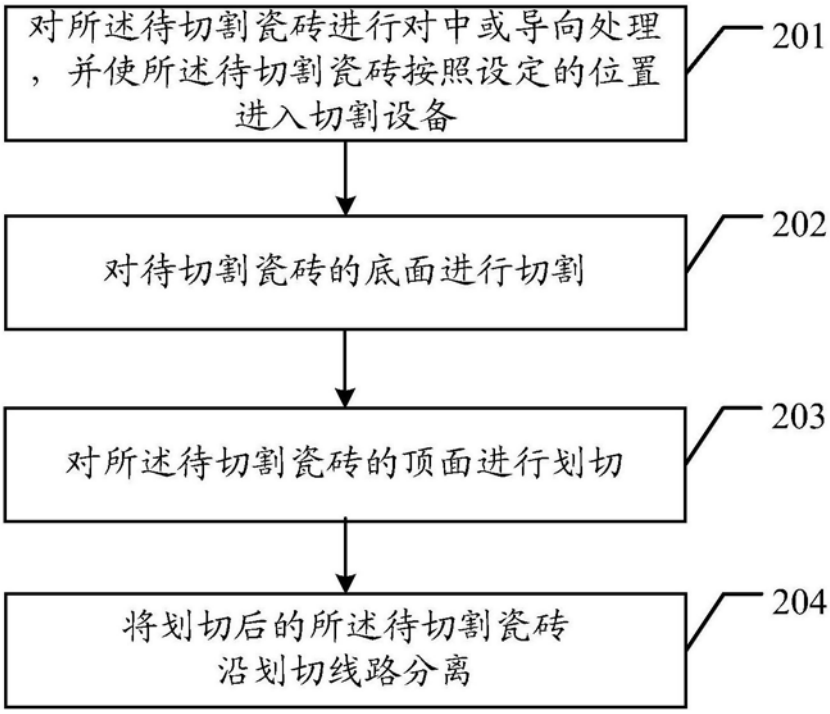

对所述待切割瓷砖进行对中或导向处理，并使所述待切割瓷砖按照设定的位置进入切割设备
201
对待切割瓷砖的底面进行切割
202
对所述待切割瓷砖的顶面进行划切
203
将划切后的所述待切割瓷砖沿划切线路分离
204

图2

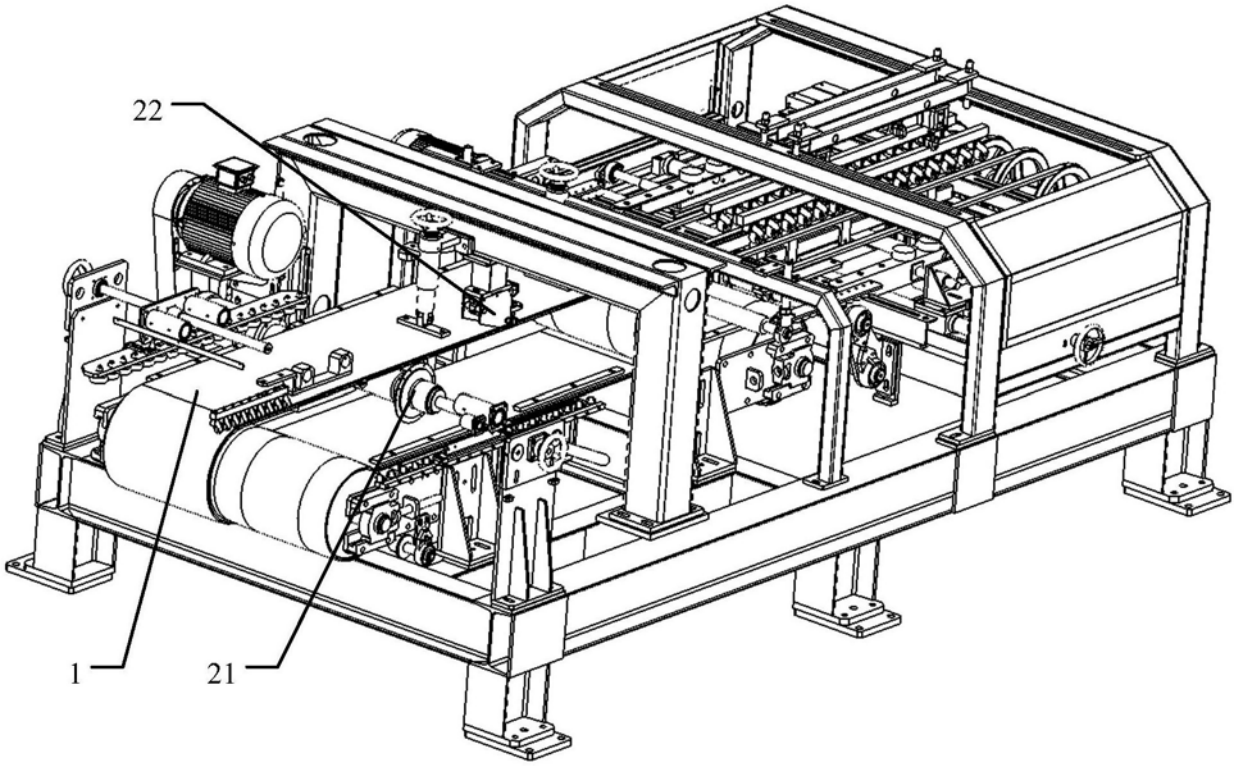


图3

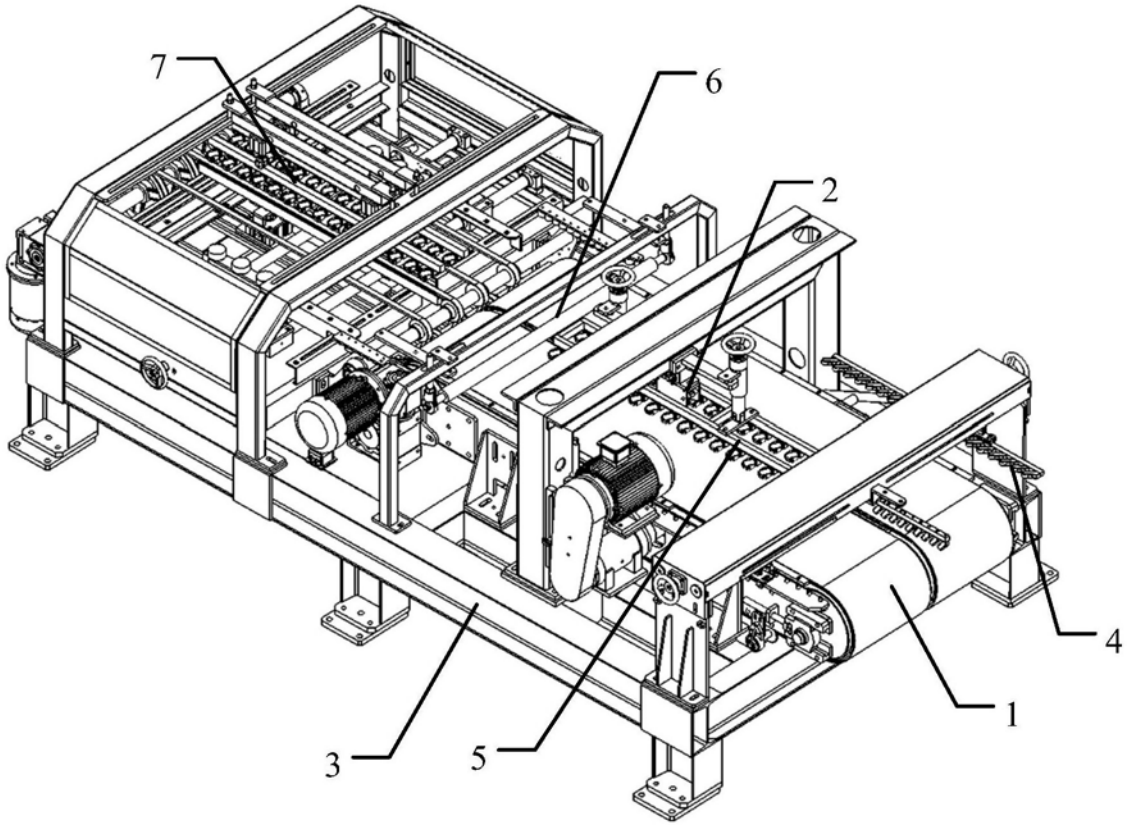


图4

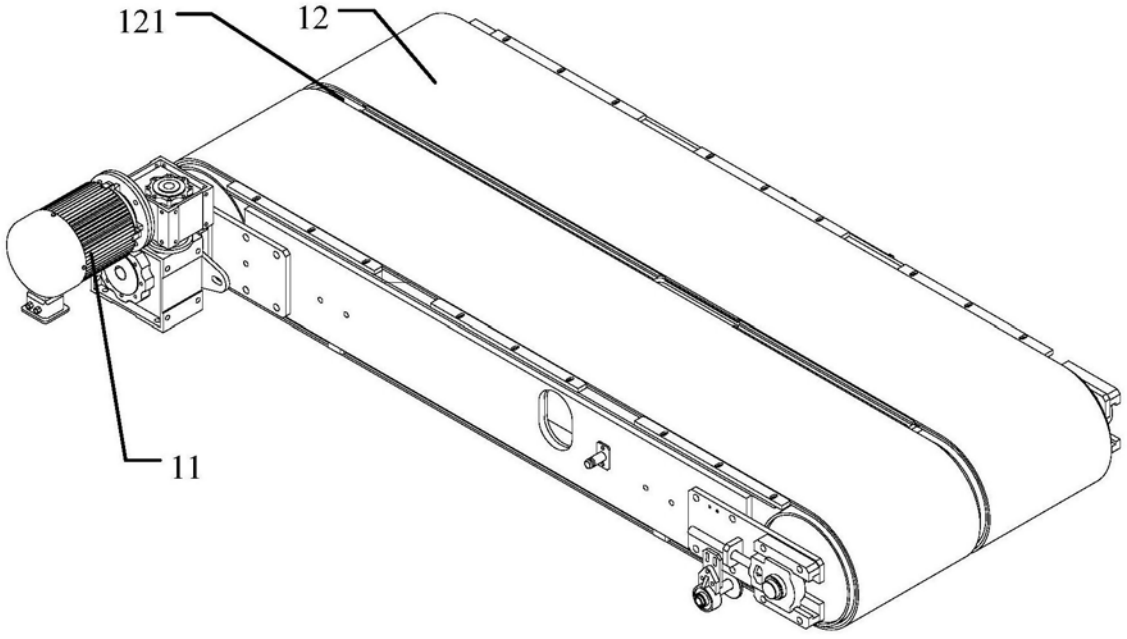


图5

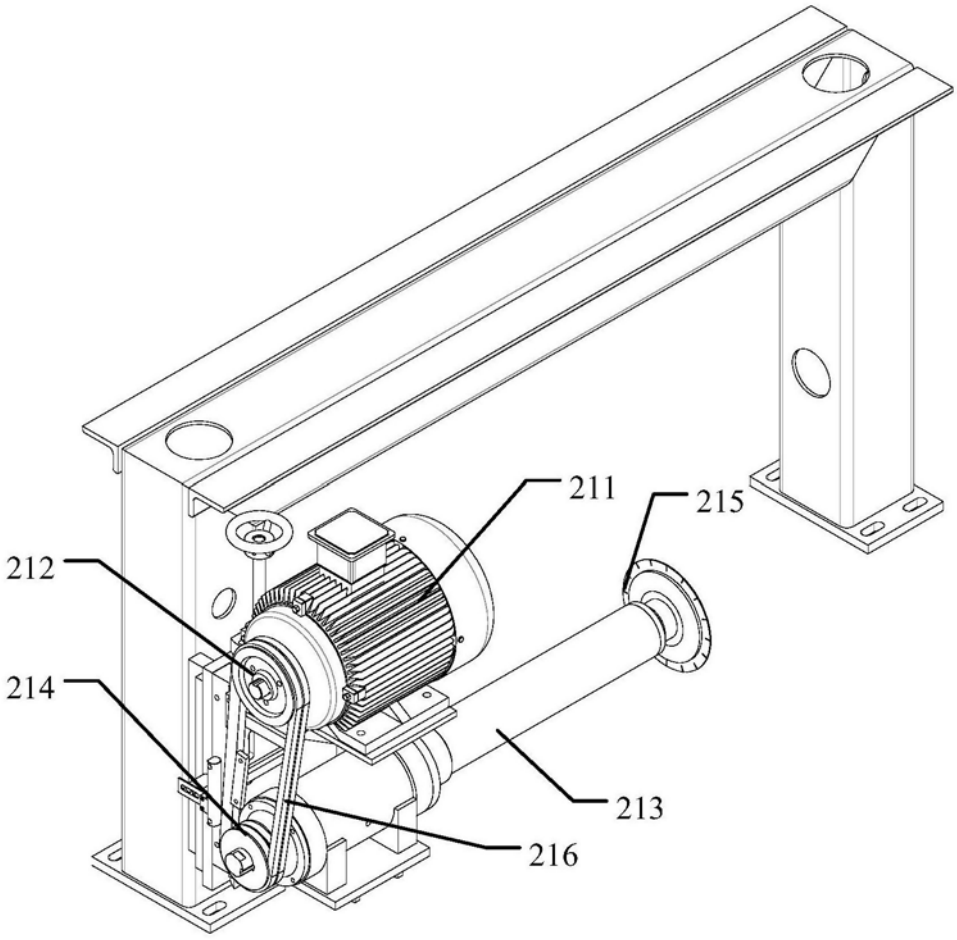


图6

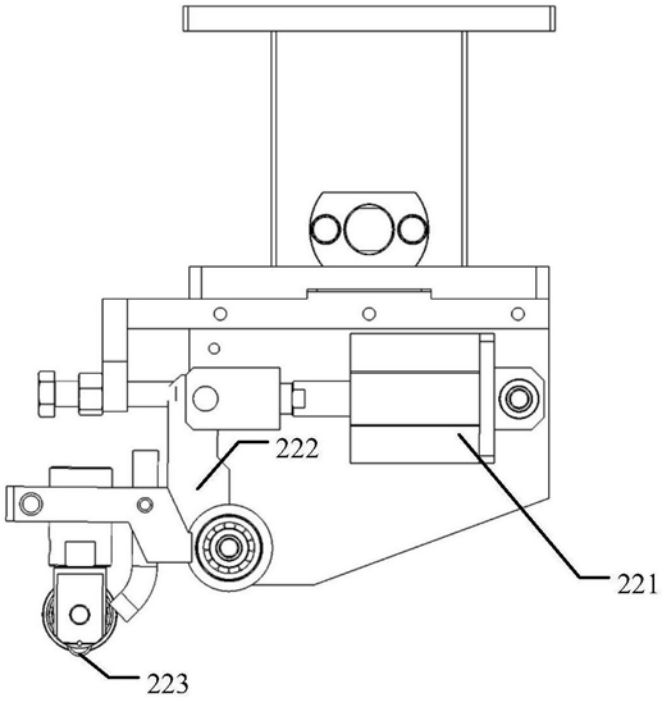


图7

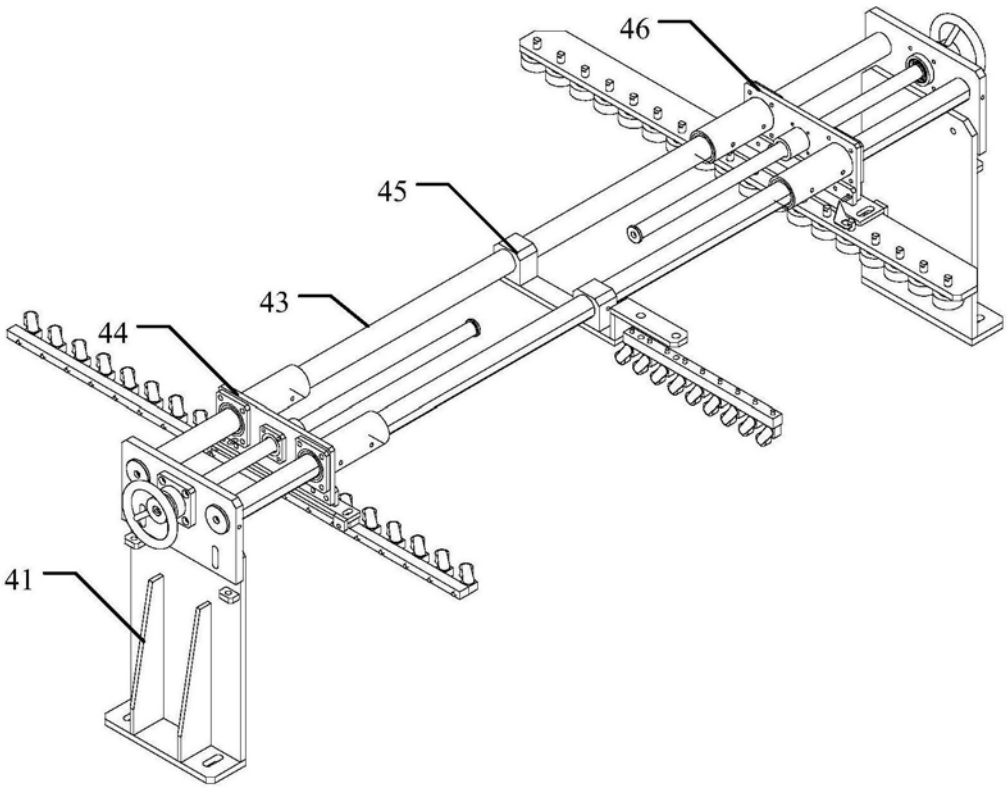


图8

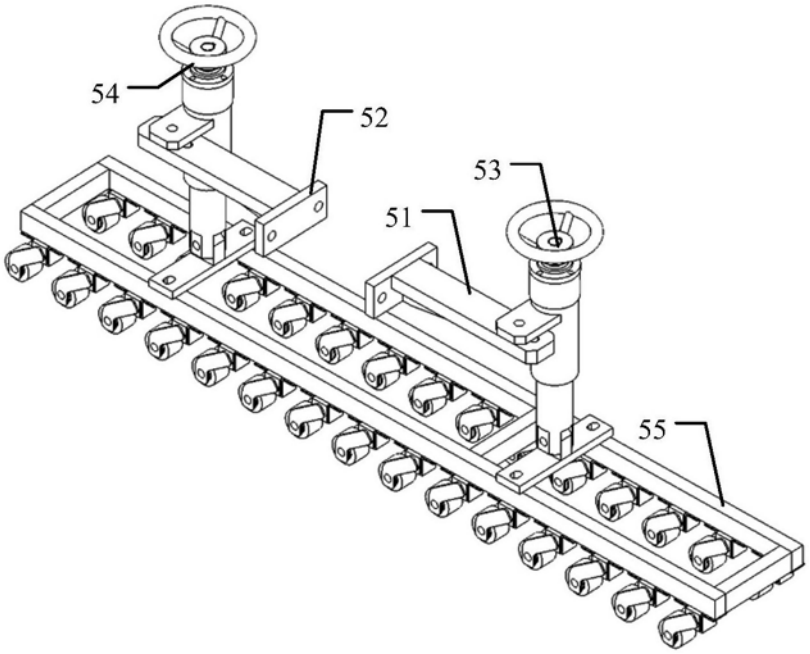


图9

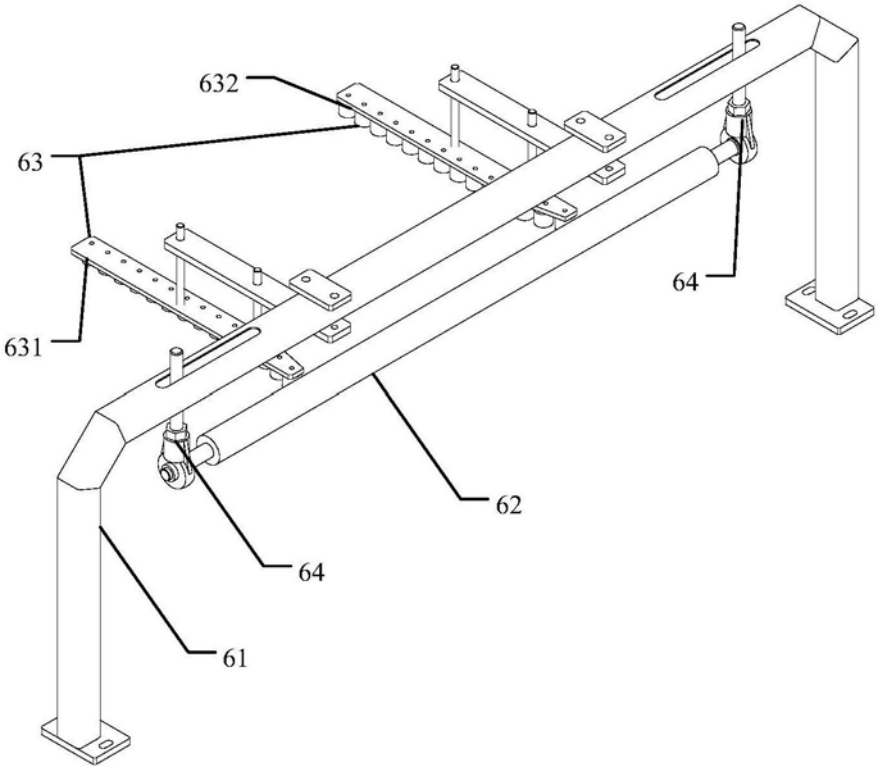


图10

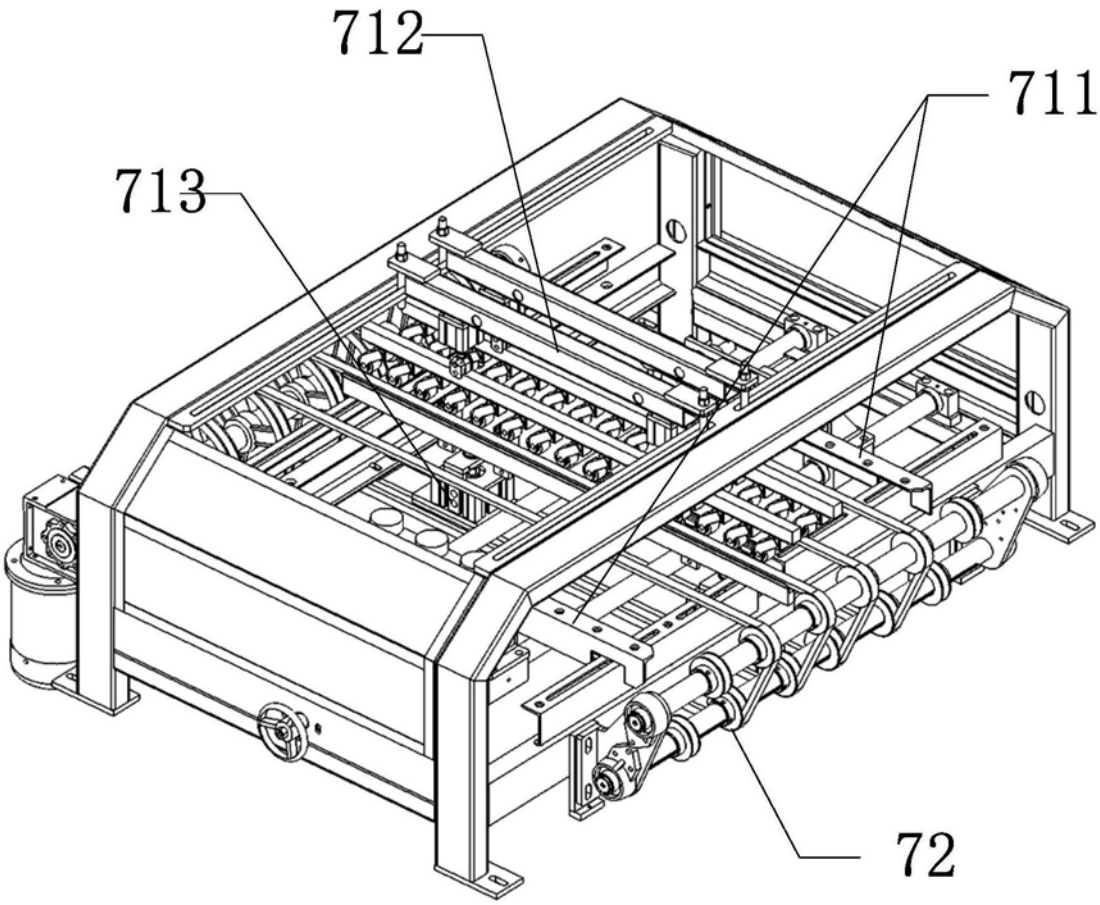


图11